

中微半导体设备（上海）股份有限公司

关于拟签署合作意向协议书的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次拟签署的《合作意向协议书》为意向性框架协议，截至本公告披露之日，双方暂未明确具体的合作方式及合作项目。具体合作事项需协议双方根据实际情况共同协商后确定，合作事项存在不确定性。
- 本协议不涉及具体金额，无需提交董事会或股东大会审议通过。
- 本协议内容不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》及《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。
- 本协议为合作意向协议，预计对公司 2020 年业绩不构成重大影响，不会导致公司主营业务、经营范围发生变化。

一、协议签订的基本情况

中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“中微公司”或“公司”）拟与中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员

会（以下简称“临港管委会”）签署《合作意向协议书》，公司拟使用自有或自筹资金在中国（上海）自由贸易试验区临港新片区（以下简称“临港新片区”）建设高端半导体装备研发与产业化项目，项目名称和建设内容最终以相关政府主管机关的批准文件为准。

（一）协议对方的基本情况

临港新片区设立于 2019 年 8 月份，临港管委会系上海市人民政府派出机构，统筹管理和协调临港新片区有关行政事务。

公司与临港管委会不存在关联关系。

（二）签订协议已履行的审议决策程序

本次拟签署的《合作意向协议书》仅为框架性协议，截至本公告披露之日，双方暂未明确具体的合作方式及合作项目，不涉及具体金额，无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将在具体合作事宜明确后，按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等规定和要求，履行相应的审批程序及信息披露义务。

二、协议的主要内容

（一）协议双方

甲方：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会

乙方：中微半导体设备（上海）股份有限公司

（二）合作主要内容

1、甲方将积极支持乙方项目在经认定的范围内享受临港地区政策，给予项目方产业、税收、人才等方面相关扶持配套。

2、乙方同意将乙方高端半导体装备研发与产业化项目落地于临港新片区范围内。

3、在乙方履行其在本协议及后续协议项下义务、承诺及责任的前提下，甲方协助乙方积极争取园区工业用地，满足乙方的生产、办

公、研发等需要。

4、本协议为甲乙双方进行合作达成的初步意向，具体合作事宜甲乙双方将进一步协商确定并签署正式协议。

三、对上市公司的影响

（一）本次拟签署的合作意向协议，预计对公司 2020 年度的业绩不构成重大影响，对公司长期经营的影响需视后续具体业务的推进和实施情况而定。

（二）本次合作双方将充分发挥各自的资源优势推动双方在临港新片区的发展，符合公司长远规划，对公司未来主营业务的增长将产生积极影响。

四、重大风险提示

本协议为意向性框架协议，具体合作事项需协议双方根据实际情况共同协商后确定，合作事项存在不确定性。本协议相关约定在付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性，具体事项以正式签订协议为准。

公司将密切关注上述事项的进展情况，并按照有关法律法规，及时履行相应的审批程序及信息披露义务。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会

2020 年 2 月 13 日